

情况说明

现项目组拟与中关村芯园（北京）有限公司，签订 82.2182 万元外包合同，用以进行芯片代加工。

我院鲁文高老师承担的 光电“感、存、算”一体智能芯片技术项目-课题二，红外感算一体芯片研究&课题三，感存算一体化三维集成研究|鲁文高协作项目（财务账号：8201702234），研究周期 2023 年 12 月至 2025 年 12 月，总经费 500 万，目前已到账 388 万；支出科目外协费，该科目预算金额 260 万，剩余金额 251 万。

1. 选用说明：中关村芯园（北京）有限公司。该公司与北京大学有长期的合作历史，产品良率高、性能稳定，加工周期较短，报价相比同类公司经济性好。

2. 关联关系：项目组与外包单位无关联关系。

3. 项目负责人承诺：

本人已充分了解并同意严格遵守国家、学校制定的科研项目管理、保密管理规定；维护北京大学校名、校誉和合法权益；

本人对经费使用的相关性、合理性、真实性和价格公允等相关性负责；

已在企业信息网查询并确认该公司相关资质。

我认为此项外包合理，同意订立此外包合同，同意此项经费支出。

项目负责人：



2025 年 6 月 12 日